



# 2022年3月期(第46期) 決算説明資料

証券コード:5217



1. 2022年3月期決算
2. 2023年3月期業績予想
3. 半導体市場予測
4. 中国第三工場新設
5. 新型コロナウイルス感染症関連



▲蔵王工場

# 1. 2022年3月期決算

- (1) 実績ハイライト（連結）
- (2) 経営成績（連結）
- (3) 経営成績（単体）
- (4) 売上推移（連結）
- (5) 設備投資額・減価償却費（連結）
- (6) 製品別売上高
- (7) 海外売上比率の推移
- (8) 配当金の推移



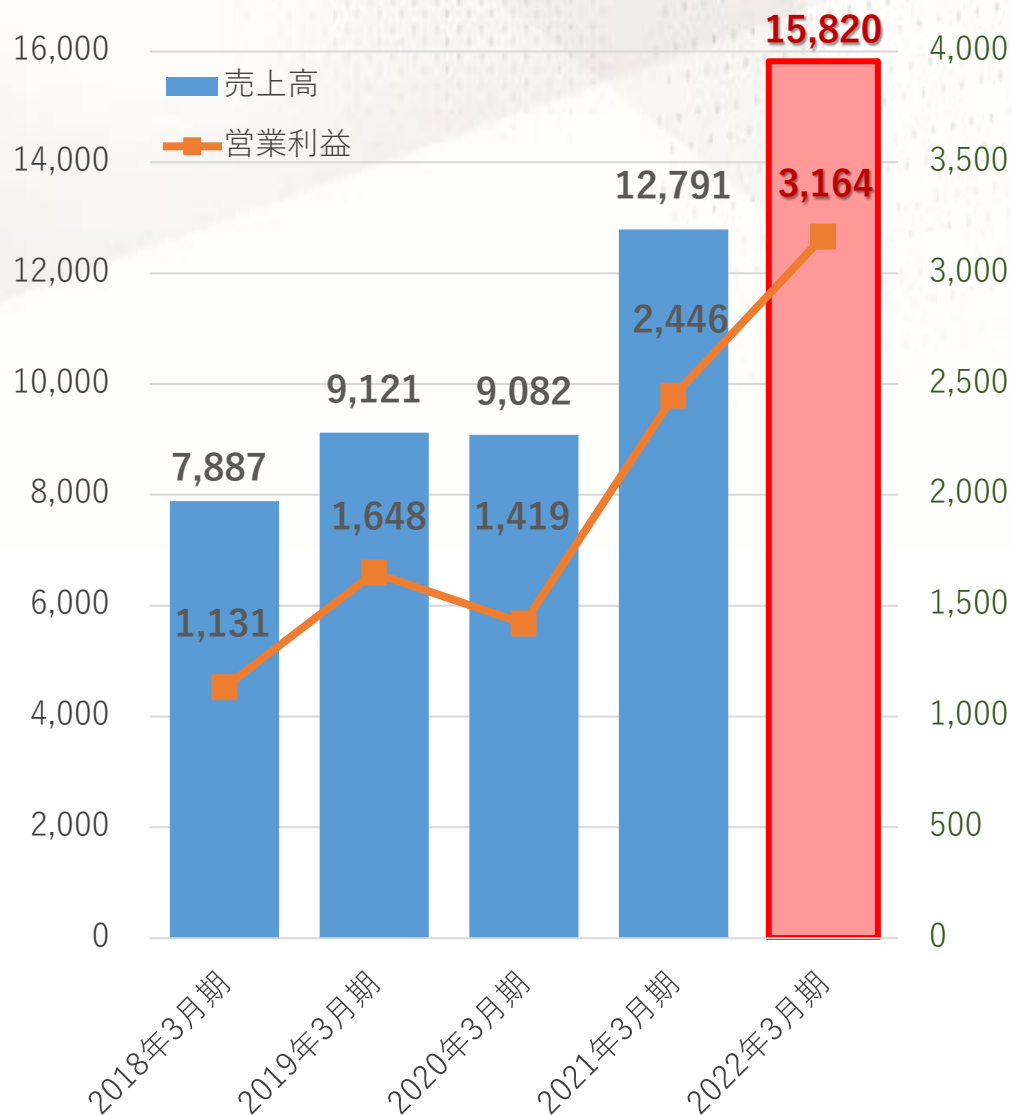
▲蔵王南工場



# 1. 2022年3月期決算

## 1-(1)実績ハイライト (連結)

(単位：百万円)



営業利益率  
20.0%

ROE  
17.6%

自己資本比率  
75.3%

売上高計画達成率  
120.8%

営業利益計画達成率  
128.6%

## 1－(2)経営成績（連結）

（単位：百万円）

|      | 2020年3月期<br>（第44期） |        | 2021年3月期<br>（第45期） |       | 2022年3月期<br>（第46期） |       |
|------|--------------------|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 売上高  | 9,082              | △0.4%  | 12,791             | 40.8% | 15,820             | 23.7% |
| 営業利益 | 1,419              | △13.9% | 2,446              | 72.4% | 3,164              | 29.4% |
| 経常利益 | 1,480              | △13.1% | 2,368              | 60.0% | 3,231              | 36.4% |
| 純利益  | 992                | △14.5% | 1,606              | 61.8% | 2,200              | 37.0% |

注）％表示 対前年同期比増減率

## 1－(3)経営成績（単体）

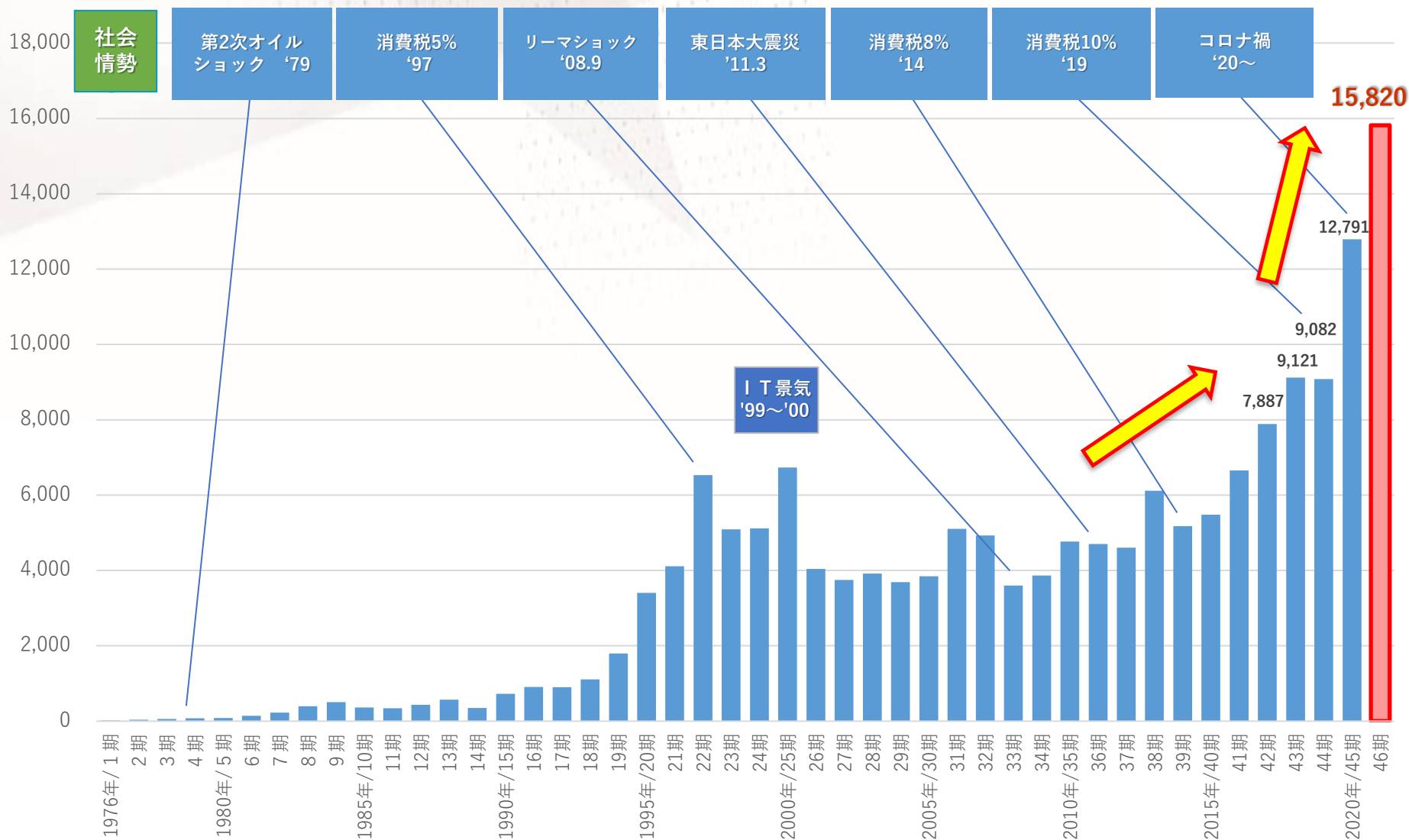
（単位：百万円）

|      | 2020年3月期<br>（第44期） |        | 2021年3月期<br>（第45期） |       | 2022年3月期<br>（第46期） |       |
|------|--------------------|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 売上高  | 8,291              | △1.5%  | 11,441             | 38.0% | 13,887             | 21.4% |
| 営業利益 | 1,039              | △12.9% | 1,613              | 55.3% | 2,243              | 39.1% |
| 経常利益 | 1,568              | 26.0%  | 1,714              | 9.3%  | 2,497              | 45.6% |
| 純利益  | 1,196              | 40.6%  | 1,173              | △1.9% | 1,732              | 47.7% |

注）％表示 対前年同期比増減率

## 1-(4) 売上推移 (連結)

(単位：百万円)



## 1－(5)設備投資額・減価償却費（連結）

（単位：百万円）

|       | 2018年3月期<br>（第42期） | 2019年3月期<br>（第43期） | 2020年3月期<br>（第44期） | 2021年3月期<br>（第45期） | 2022年3月期<br>（第46期） |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 設備投資額 | 1,232              | 954                | 491                | 1,156              | 2,425              |
| 減価償却費 | 450                | 539                | 573                | 590                | 608                |

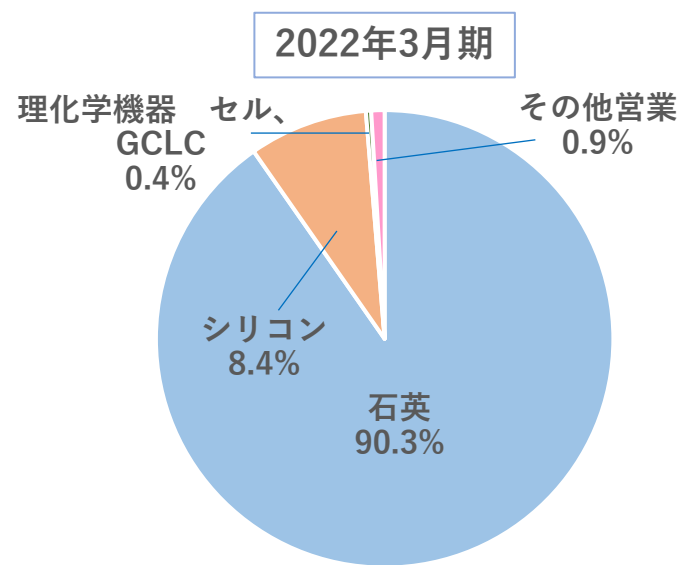
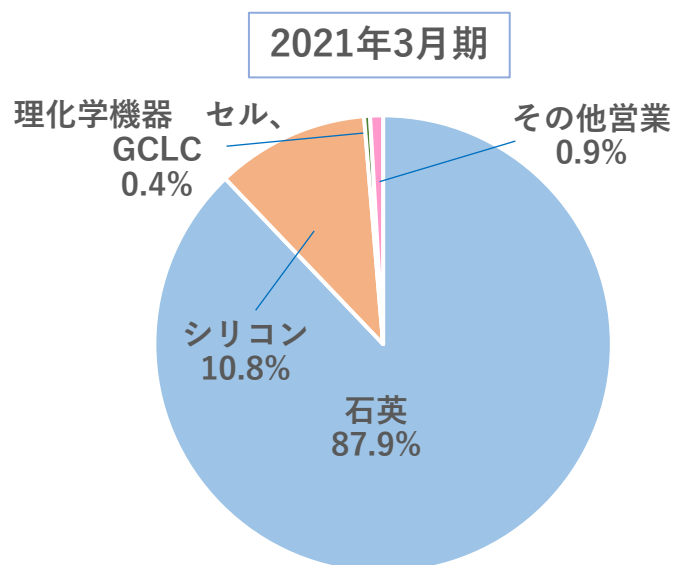


中国第一工場・第二工場の隣接地に  
第三工場を新設。

## 1－(6)製品別売上高

(単位：百万円)

| 主要製品              | 2021年3月期<br>(第45期) |        |        | 2022年3月期<br>(第46期) |        |        |
|-------------------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
|                   | 売上高                | 構成比    | 前年比    | 売上高                | 構成比    | 前年比    |
| 石英                | 11,240             | 87.9%  | 143.1% | 14,284             | 90.3%  | 127.1% |
| シリコン              | 1,380              | 10.8%  | 143.1% | 1,327              | 8.4%   | 96.2%  |
| 理化学機器 セル、<br>GCLC | 53                 | 0.4%   | 88.6%  | 59                 | 0.4%   | 111.3% |
| その他営業             | 116                | 0.9%   | 57.8%  | 149                | 0.9%   | 128.5% |
| 総計                | 12,791             | 100.0% | 140.8% | 15,820             | 100.0% | 123.7% |

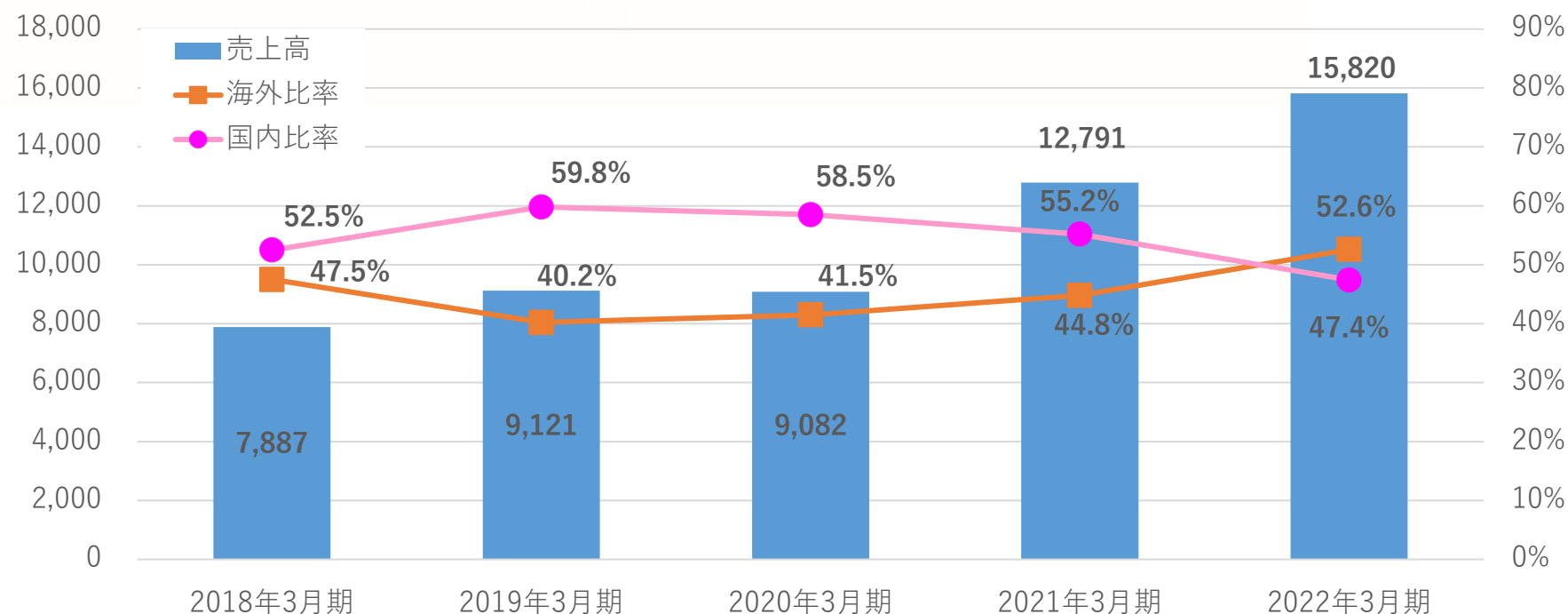




## 1-(7) 海外売上比率の推移

(単位：百万円)

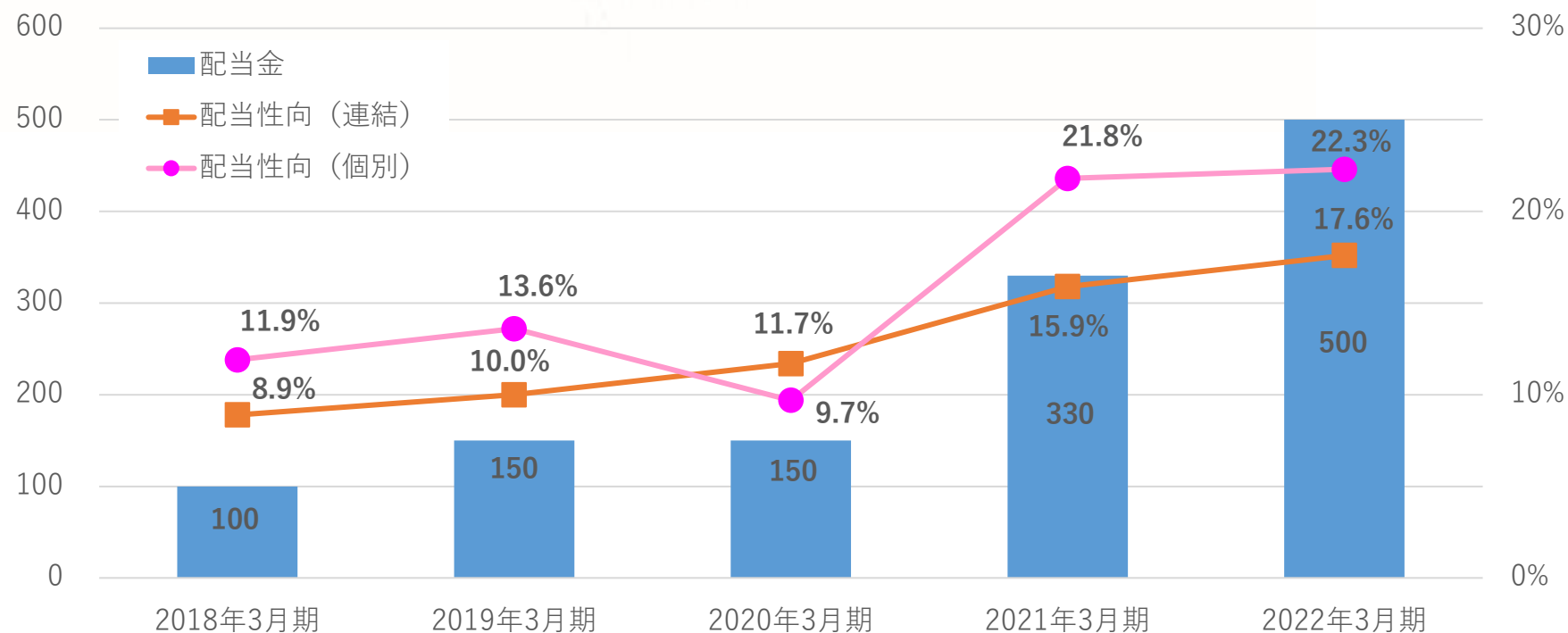
| 区 分 | 2018年3月期<br>(第42期) |        | 2019年3月期<br>(第43期) |        | 2020年3月期<br>(第44期) |        | 2021年3月期<br>(第45期) |        | 2022年3月期<br>(第46期) |        |
|-----|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
|     | 合計                 | 比率     | 合計                 | 比率     | 合計                 | 比率     | 合計                 | 比率     | 合計                 | 比率     |
| 国 内 | 4,142              | 52.5%  | 5,453              | 59.8%  | 5,317              | 58.5%  | 7,059              | 55.2%  | 7,502              | 47.4%  |
| 国 外 | 3,745              | 47.5%  | 3,668              | 40.2%  | 3,765              | 41.5%  | 5,731              | 44.8%  | 8,317              | 52.6%  |
| 合 計 | 7,887              | 100.0% | 9,121              | 100.0% | 9,082              | 100.0% | 12,791             | 100.0% | 15,820             | 100.0% |



## 1－(8)配当金の推移

(単位：円)

|           | 2018年3月期<br>(第42期) | 2019年3月期<br>(第43期) | 2020年3月期<br>(第44期) | 2021年3月期<br>(第45期) | 2022年3月期<br>(第46期) |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1株当たり配当金  | 100.00             | 150.00             | 150.00             | 330.00             | 500.00             |
| 配当性向 (連結) | 8.9%               | 10.0%              | 11.7%              | 15.9%              | 17.6%              |
| 配当性向 (個別) | 11.9%              | 13.6%              | 9.7%               | 21.8%              | 22.3%              |



## 2. 2023年3月期業績予想

### 2. 2023年3月期業績予想（連結）

（単位：百万円）

|      | 第2四半期 |       | 通期     |       |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 売上高  | 8,430 | 10.9% | 17,000 | 7.5%  |
| 営業利益 | 1,570 | 1.4%  | 3,220  | 1.8%  |
| 経常利益 | 1,560 | 3.5%  | 3,220  | △0.4% |
| 純利益  | 1,110 | 8.8%  | 2,280  | 3.6%  |

※2022年3月期決算短信の公表値

注）％表示 対前年同期比増減率



### 3. 半導体市場予測

- (1) 世界の地域別半導体市場規模
- (2) 世界地域別半導体市場予測

出所：WSTS2021秋季半導体市場予測



## 3. 半導体市場予測

### 3－(1)世界の地域別半導体市場規模

(単位：百万ドル)

|     | 2017年   | 2018年   | 2019年   | 2020年   | 2021年予測 | 2022年予測 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 米州  | 88,494  | 102,997 | 78,619  | 95,366  | 118,835 | 131,084 |
| 欧州  | 38,311  | 42,957  | 39,816  | 37,520  | 47,126  | 50,467  |
| A/P | 248,821 | 282,863 | 257,879 | 271,032 | 343,419 | 372,317 |
| 日本  | 36,595  | 39,961  | 35,993  | 36,471  | 43,581  | 47,621  |
| 合計  | 412,221 | 468,778 | 412,307 | 440,389 | 552,961 | 601,490 |
| 前年比 | 121.6%  | 113.7%  | 88.0%   | 106.8%  | 125.6%  | 108.8%  |

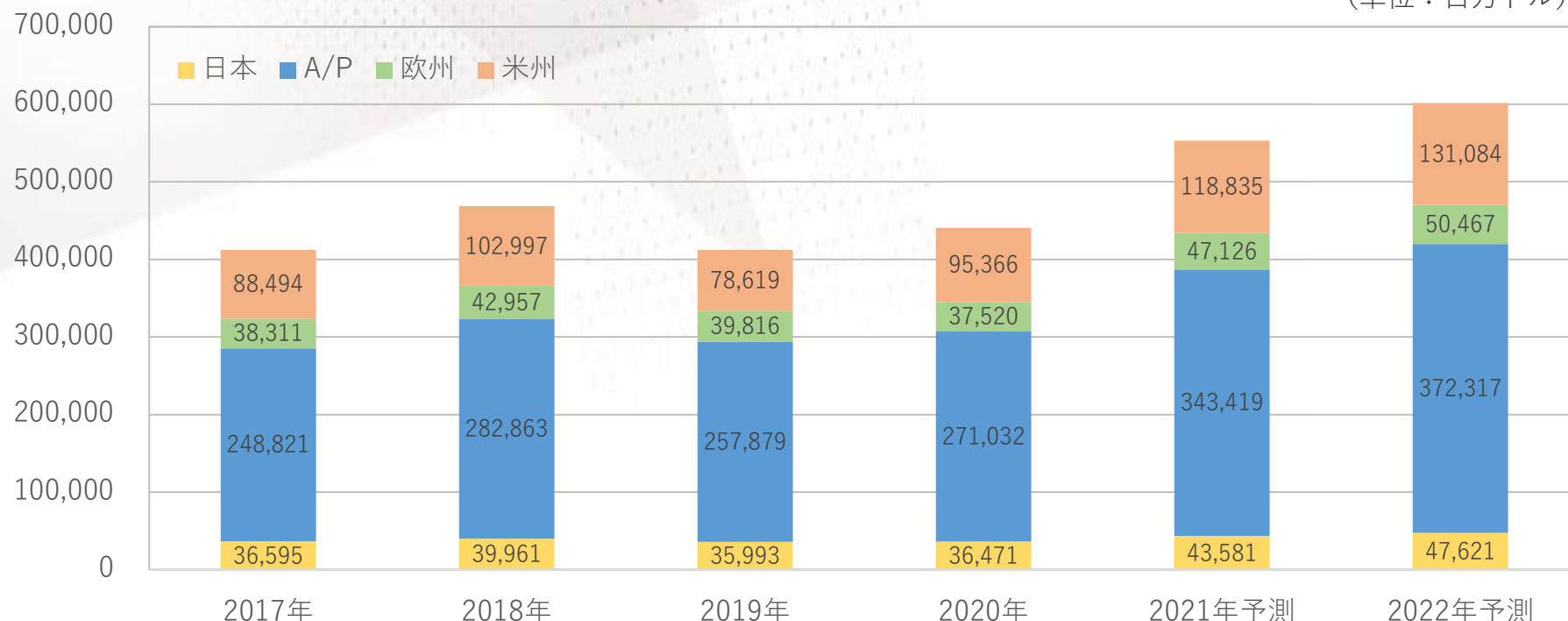
※「A/P」とはアジア太平洋の略

資料：WSTS 2021年秋季半導体市場予測



## 3-(2)世界地域別半導体市場予測

(単位：百万ドル)



世界半導体市場について

- ◆ 2020年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う巣籠り需要が牽引し、前年比6.8%増
- ◆ 2021年は2020年に半導体市場を牽引したプラス需要が継続し、またワクチン接種の進展に伴う経済活動の再開もあり、半導体は幅広く需要が強くなると思われ、同25.6%増と予測
- ◆ 2022年は足下においても多くの用途で半導体需要が旺盛であり、この傾向が当面は継続すると思われ、同8.8%増と予測

資料：WSTS 2021年秋季半導体市場予測

## 4. 中国第三工場新設

◇ 中国第一工場・第二工場の隣接地に第三工場を新設。（2021年11月竣工）

◇ 最大60台の機械設備設置が可能であり、最大約25億円/年の増産規模となります。



## 5. 新型コロナウイルス感染症関連

### < 弊社の対応 >

日々変化する状況に応じて、お客様、従業員及びその家族の安全確保・感染予防、感染拡大防止を最優先とする方針のもと、事業継続に向けた対応を引き続き実施しております。

お客様に対しましては、引き続き各種オンラインシステムを活用した商談や営業活動を行っております。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めつつ、お客様からのご注文への対応、商品出荷対応等は、通常通り実施しております。

また、当社従業員に対しては、引き続き在宅勤務及び時差出勤の継続、出張の制限等を行っているほか、事業部門ごとに事業の継続に向けたコンティンジェンシープランを策定しております。

### < 事業面の影響 >

世界的なリモートワークの広がりや、データセンター等メモリー需要の高まりなどプラス要因が強いと見込まれます。

# 中期経営計画 進捗と今後の展開について

2021年度～2023年度  
( 2021.4.1～2024.3.31 )

1. 経営環境
2. 経営理念等
3. 当社のあゆみ
4. 中期経営計画期間中の成果と課題
5. 中期経営計画の概要
6. 参考資料

# 1. 経営環境

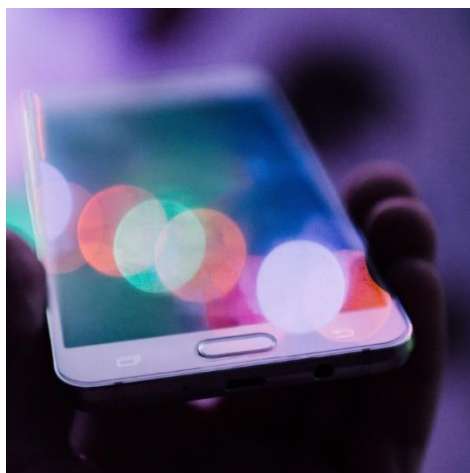
## (1) 国内経済の状況

国内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、ワクチン接種率の向上や各種施策等の効果により、緩やかな持ち直しの動きが続きました。

しかしながら、新たな変異株(オミクロン株)の感染が報告され、新規感染者数が増加傾向に転じることに加え、世界的な食糧・エネルギー価格の高騰やロシア・ウクライナ情勢など先行き不透明な状況が続く展開となっています。



## (2) 半導体業界の状況



半導体業界におきましては、5GやAI、IoT、自動運転等の需要の高まりから、半導体の供給不足が顕在化する状況となりました。

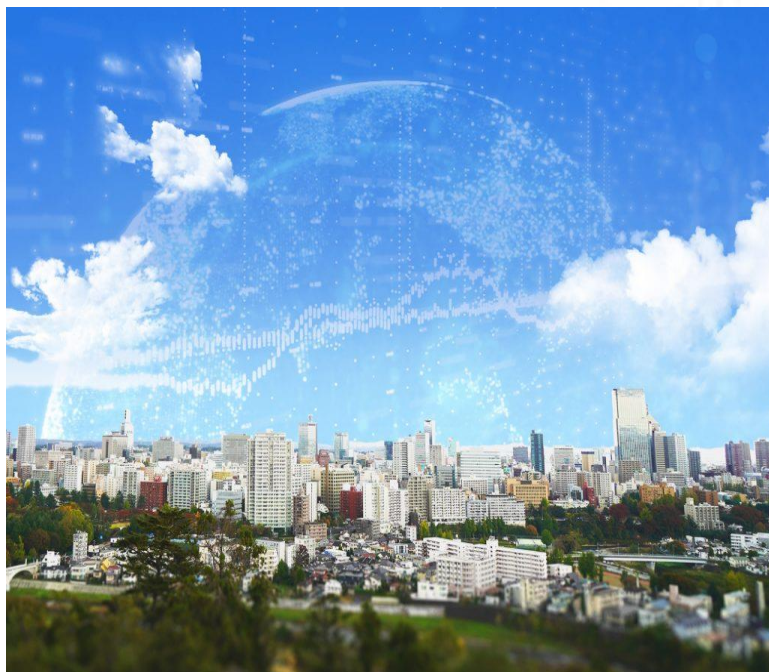
こうした需給逼迫は当分続くとの見通しから、各メーカーの積極的な設備投資も継続しており、半導体市場は着実に拡大している状況です。



### (3) 当社の現況と今後の見通し

このような環境の中、当社では、これまでに蓄えた豊富な受注残高と、工場の高稼働に伴う量産効果を背景に、**2022年3月期は、売上高・利益ともに上場以来最高額を更新することができました。**

受注残高についても**過去最高レベルの水準で推移しました。**



こうした中、当社工場では、国内・海外ともに2交代制を併用しながらのフル操業が続いています。現状の高水準の受注に加え、将来に向けたお取引先からの増産要請も多数抱えていることや、データセンター、5G、AI、IoT、自動運転等による半導体需要の急拡大が見込まれることから、**設備増強や効率化による工場のキャパシティアップが、当社における重要な課題**であると言えます。



## 2. 経営理念等

### (1) 経営理念

企業の維持、発展をならしめ、  
社員個々の幸福を勝ち取り、  
社会に対し社会性を十分発揮して、  
その存在価値を高めること

(※「創立の根本精神及経営理念」より)

### (2) スローガン

道は一つ、共に進もう

(※「創立の根本精神及経営理念」より)



### (3) 企業行動指針

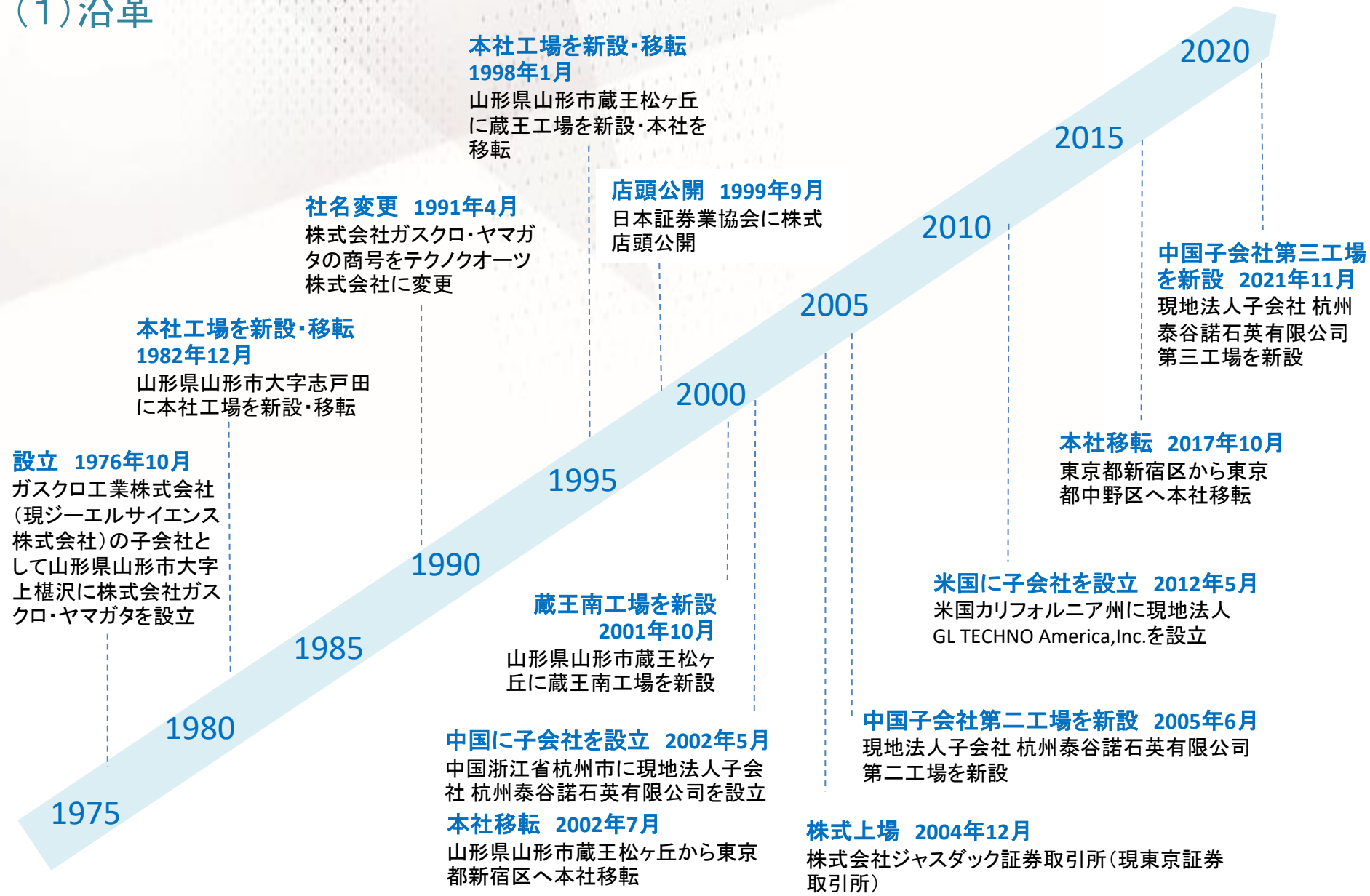
- ①お客様からの信頼の獲得
- ②基本的人権の尊重
- ③倫理的行動の実践による  
法令および企業倫理の遵守

- ④公正・誠実な取引の実施
- ⑤反社会的勢力との決別
- ⑥環境問題への取り組み
- ⑦企業情報の開示

(※「ジーエルサイエンスグループ企業行動指針」より)

# 3. 当社のあゆみ

## (1) 沿革



## (2) 製造技術/製造プロセス

確かな製品を提供するために、最新の加工・洗浄・検査設備を導入しています

優れた耐熱性・高純度・透過性を  
併せ持つ高品質石英ガラス素材



直径 約1,800mm

コア抜き機



ニアネット加工  
(ウォータージェット)



バンドソー





## 機械加工

半導体・液晶・理化学分野等の各種製品に対応するため、幅広い機械加工設備を保有しております。また、近年の高精細化に対応するため、最新の精密機械加工設備の導入を行っております。

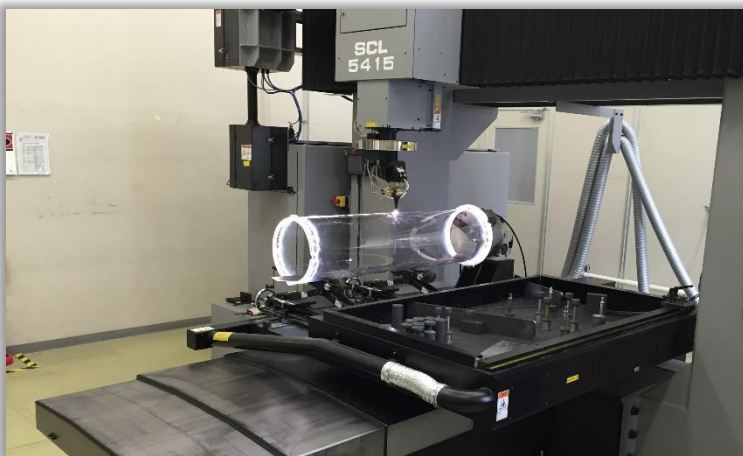
### 平面研削(レシプロ)



### 平面研削(ロータリー)



### レーザー加工機



### 超音波マシニングセンタ



## 火加工

半導体製造装置に使用される反応管やウェハポートなどの製品を作り出すために、高度な溶接・成形技術が必要とされます。火炎加工における汚染を低減するために工程内のクリーン化にも積極的に取り組んでおります。

### 焼仕上げ



### 大型電気炉



### ロボット化

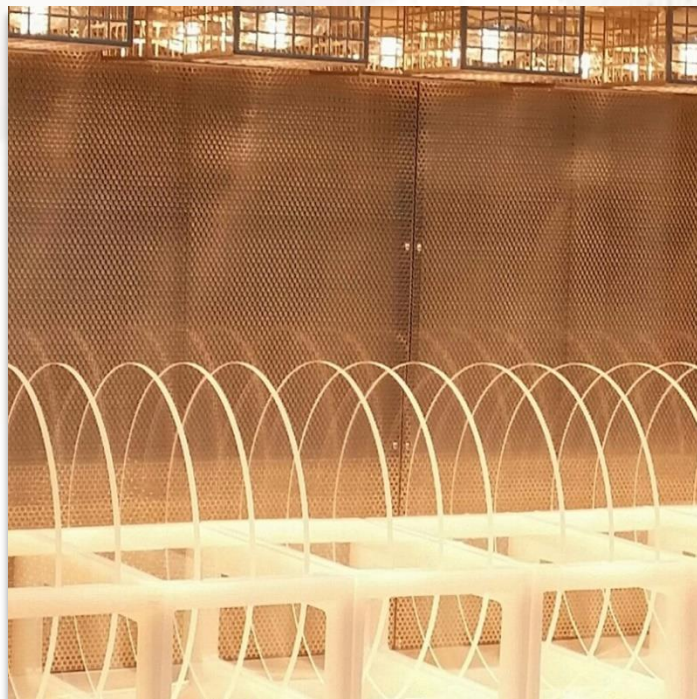




## 洗浄

厳しい汚染管理が求められる半導体・液晶分野等の製品に対応するため、各工場にクリーン洗浄設備を導入し、クリーンルーム内で洗浄から包装まで一貫して行っております。

### クリーン洗浄



### クリーンベンチ



### クリーンパック



## 検査

年々高精細化する製品群に対応するため、最新の検査装置・分析機器を導入し、大型製品から精密小物部品に至るまで高精度の検査を行い、品質レベルの向上に取り組んでおります。

### 透過率計



### 三次元測定機(接触式)



### 画像三次元測定機(非接触式)



## 4. 中期経営計画期間中の成果と課題

### (1) 中期経営計画初年度の成果

- ①過去最高の売上高および営業利益の達成
- ②中国第三工場の稼働による量産開始
- ③内部管理体制の強化および各種システムツールの開発

### (2) 今後の成長に向けた課題

- ①各工場の生産性向上による生産能力の増強
- ②厳しい収益環境下での営業展開、営業力強化
- ③業務効率化、経営基盤強化、人材育成等の推進



# 5. 中期経営計画の概要

## (1) 中期経営計画のビジョン

石英ガラス・シリコン加工における世界有数の  
「半導体関連精密パーツ総合メーカー」としての地位確立

## (2) 中期経営計画の主な戦略

### ①生産能力増強

- ・中国第三工場の稼働拡大や各工場の生産性向上等により、生産能力の更なる増強を図ります。
- ・品質管理の高度化を進めるとともに、社外パートナー、外注先等との連携強化を通じて、生産能力の向上を目指します。

### ②営業力強化

- ・コロナ後のお取引先との関係強化を図るとともに、高付加価値製品の開発と拡張を行い、石英・シリコンの量産品のマーケット拡大を目指します。
- ・シリコン製品の開発品、量産品の更なる売り込み強化するとともに、火加工製品等、高難易度製品の拡大を図ります。





### ③業務効率化

- ・業務フロー、作業手順等の見直しを進め、業務自動化・効率化等のDXを推進します。
- ・テレワーク、会議システム等、効率化に資するシステムツールの更なる活用を図ります。

### ④経営基盤強化

- ・ESG経営、SDGsへの対応を進めるとともに、会社法改正への対応や新市場区分への移行に伴うコーポレートガバナンスコード強化への対応を行います。
- ・財務指標や株価を意識した経営を行い、IR機能強化、リスクマネジメント強化を図ります。

### ⑤人材育成

- ・各種研修の充実、業務マニュアルの作成推進、人事ローテーションの活発化等により、優秀な人材の育成に努めます。



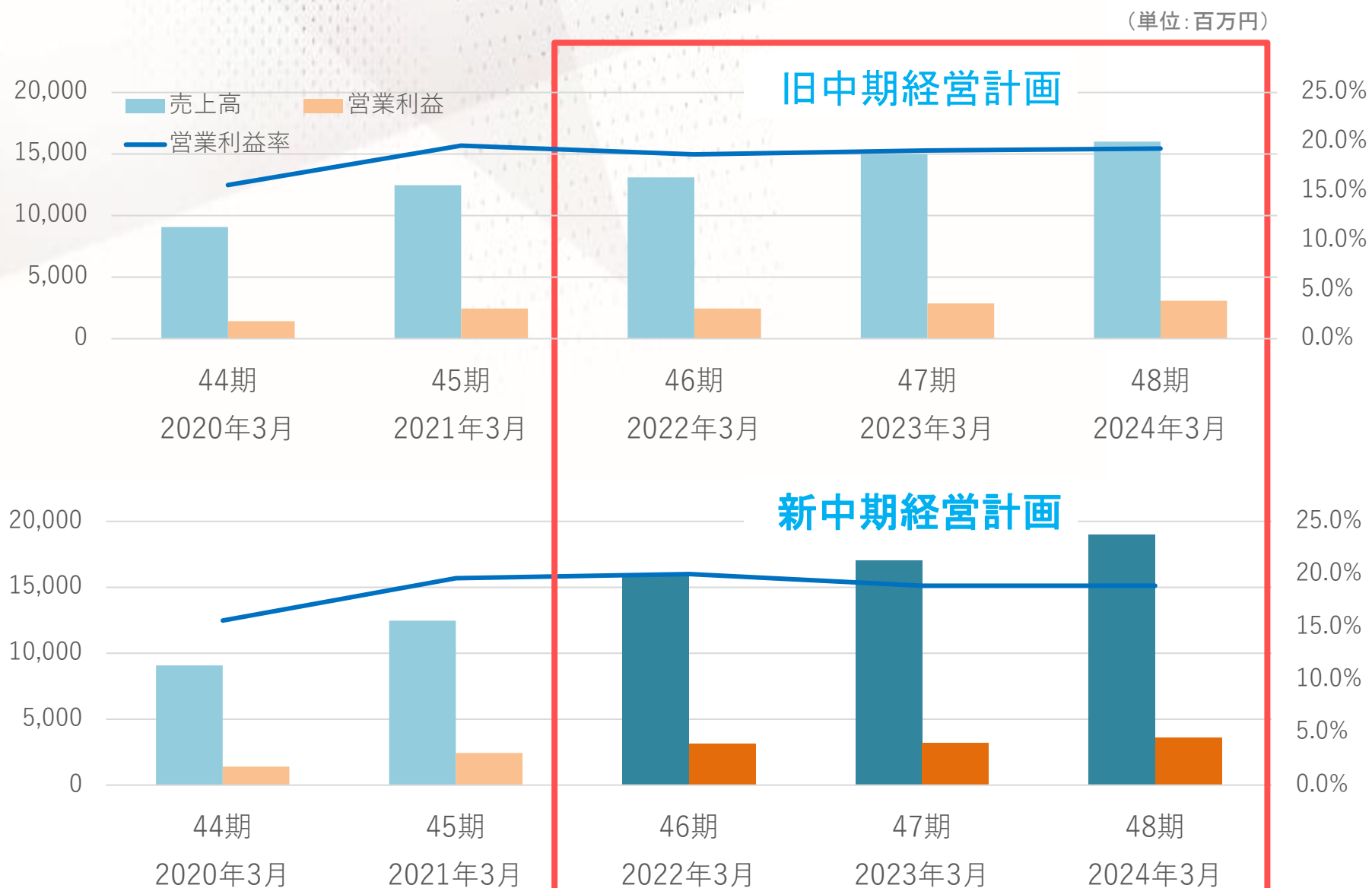
## 2021年5月27日に発表した中期経営計画の経営目標を修正いたします

中期経営計画初年度の2022年3月期は、半導体業界の活況をうけた好調な受注により、連結売上高は計画比20.8%増の15,820百万円、連結営業利益は計画比28.6%増の3,164百万円と、目標を達成することができました。

今後も、世界的なリモートワークの広がりやデータセンター等メモリー需要の高まりなどプラス要因が強く、5G通信やIoT、AI/ディープラーニング、自動運転の本格化等でデータ量の更なる増加も見込まれ、半導体需要のトレンドは引き続き拡大していくものと予想されます。このような状況から、原材料の高騰や物流コストの上昇など収益環境に厳しさはあるものの、中長期的に受注拡大が持続するとの見通しにより2023年3月期以降の経営目標を相応に上方修正することといたしました。

(単位:百万円)

|       | 46期<br>2022年3月 |        | 47期<br>2023年3月 |        | 48期<br>2024年3月 |        |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 売上高   | 旧計画            | 13,100 | 旧計画            | 15,000 | 旧計画            | 16,000 |
|       | 実績             | 15,820 | 新計画            | 17,000 | 新計画            | 19,000 |
| 営業利益  | 旧計画            | 2,460  | 旧計画            | 2,860  | 旧計画            | 3,090  |
|       | 実績             | 3,164  | 新計画            | 3,220  | 新計画            | 3,590  |
| 営業利益率 | 旧計画            | 18.8%  | 旧計画            | 19.1%  | 旧計画            | 19.3%  |
|       | 実績             | 20.0%  | 新計画            | 18.9%  | 新計画            | 18.9%  |



※46期は実績

# 6. 参考資料

## (1) グループ会社の連携

### ジーエルサイエンスグループ

#### 分析機器事業

ジーエルサイエンス  
株式会社



GL Sciences B.V.

GL Sciences, Inc.

技尔(上海)商貿有限公司

株式会社グロース

株式会社フロム



#### 半導体事業

テクノクォーツ  
株式会社



杭州泰谷諾石英有限公司



HangZhou  
Techno  
Quartz

GL TECHNO AMERICA, Inc.



#### 自動認識事業

ジーエルソリューションズ  
株式会社





## (2) ESG経営への取り組み

中期経営計画の主な戦略「④経営基盤強化」の中でも触れておりますとおり、当社では、ESG「(環境: Environment)、(社会: Social)、(企業統治: Governance)」を経営に取り入れ、企業価値の向上を目指しています。

- ・「**環境**」につきましては、政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、低炭素・循環型社会への転換に貢献すべく、国内・海外(中国)の当社工場において、極力環境に配慮した製造工法を模索するとともに、廃棄物の削減や分別に鋭意取り組んでおります。
- ・「**社会**」につきましては、半導体事業を通じて世界中の人々に便利で豊かな暮らしを提供することで社会貢献するとともに、企業活動を通じて適正な配当・納税を行うことで、広く株主・社会に利益を還元し、上場企業としての社会的責任を果たして参ります。
- ・「**企業統治**」につきましては、取締役8名中3名を独立且つ社外取締役とすることで経営の客観性を担保するとともに、会社法改正への対応や市場区分移行に伴うコーポレートガバナンスコード強化に取り組んで参ります。



### (3) SDGsへの対応

当社の主な事業領域である“半導体事業”は、SDGsの目標を達成するために欠かせない要素技術です。長年の経験と確かな技術を元に、半導体製造装置に欠かせない画期的な製品を開発し、半導体製造装置メーカーへの販売、サポート活動を通じて、様々な環境問題や社会課題の解決に貢献していきます。

また、SDGsは社会全体で共有・連携して持続的な社会を実現するために設定された目的ですが、これは「社会性を十分に発揮しながら社員の幸福を勝ち取り、維持・発展を目指す」という当社の経営理念と、ESG経営の延長線上に位置づけられるものです。

当社は本業の半導体事業を中心に、ひとつでも多くのSDGsゴールの達成に寄与できるよう邁進します。



当社の取り組み内容についてはホームページをご覧ください。( <https://www.techno-q.com/company/sdgs/> )

## (4) 株式分割

株式の分割により、当社株式の投資単位(100株)当たりの金額を引き下げることで、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、株式の流動性を高めるとともに、投資家層の拡大を図ることを目的とし、2022年9月30日(金)を基準日として、普通株式1株につき、5株の割合をもって分割いたします。



### 【分割により増加する株式数】

|                  |              |
|------------------|--------------|
| ①株式分割前の発行済株式総数   | 780,000 株    |
| ②今回の分割により増加する株式数 | 3,120,000 株  |
| ③株式分割後の発行済株式総数   | 3,900,000 株  |
| ④株式分割後の発行可能株式総数  | 15,600,000 株 |

### 【分割の日程】

|         |                |
|---------|----------------|
| ①基準日公告日 | 2022年 9月14日(水) |
| ②基準日    | 2022年 9月30日(金) |
| ③効力発生日  | 2022年10月1日(土)  |

### 【その他】

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。



# テクノオーツ株式会社

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2

ハーモニータワー

TEL: 03-5354-8171

FAX: 03-5354-8191

<https://www.techno-q.com/>

## 【免責事項】

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があることをご了承ください。